

半导体设备产品对比图

Product model		VF-690Q	VF-570Q	VF-530Q	VF-510Q	VF-300Q	VF-100Q	Model 200	RLA-310Q	RLA-120Q	SQ2-12-E	VFS-400Q	Model 205A	RLA-310Q-V	RLA-410Q-V	VF-530QHLP	VF-530QH	VF-300QH	VF-300QHS	RLH Series
晶圆大小	φ300mm	○	○	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	φ200mm	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○
	高达 φ150mm	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
	其他	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○
批量大小 (最大存储计数 / 系统)	φ300mm	100	50	-	-	-	25	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	25
	φ200mm	-	-	150	150	50	25	125	1	1	100	-	-	1	1	100	75	-	50	200
	Up to φ150mm	-	-	200	150	75	50	150	1	1	-	-	-	1	1	100	50	50	75	200
	其他 (矩形基板等)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	800	-	-	-	-	-	-	25
传输系统	晶圆 (基板)	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-
	晶圆储料器	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-
	FOUP 开启器	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FOUP 储料器	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
系统	立式炉管	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-
	卧式炉管	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
	灯退火系统	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○
	洁净烘箱系统	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	大口径立式炉管	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
SiC 功率半导体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○	○	-	
半导体	退火	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	○	-	○	-
	热氧化	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	-	○	-	○	-
	LPCVD <small>(SiN, Poly-Si, Non-Doped, P-Doped) TEOS, HTG</small>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	活化退火	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-
	杂质扩散	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
	聚酰亚胺固化	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	吸杂	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
烧结/合金	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SiC 功率半导体	活化退火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-
	热氧化	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
	渗氮/氧氮化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
	LPCVD (TEOS)	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	POA	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
接触退火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	
MEMS	热氧化	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LPCVD	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VCSEL	热氧化	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	接触退火	-	-	○	○	○	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PV (光伏)	杂质扩散	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
	热氧化	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
封装	聚酰亚胺固化	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
FPD	固化 (聚酰亚胺固化)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○
	活化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	脱氢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	玻璃料烧制	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	金属接触退火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-